

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2024-023

有研半导体硅材料股份公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“集成电路用8英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人中信证券股份有限公司发表了明确的同意意见。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）187,143,158股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2022年11月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至2024年3月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具体投入情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金累计投入比例
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	384,824,300.00	119,305,526.97	31.00%
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	357,347,600.00	61,336,440.04	17.16%
3	补充研发与运营资金	257,828,100.00	144,769,552.69	56.15%
合计		1,000,000,000.00	325,411,519.70	-

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目预计达到可使用状态时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前项目达到预定可使用状态时间	变更后项目达到预定可使用状态时间
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	2024年5月	2025年12月
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	2024年11月	2025年12月

（二）本次募投项目延期的原因

公司对部分募投项目进度适当调整主要基于以下因素：第一，受市场需求变动的影 响，公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化，使得募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异。第二，本着控制成本、提高募集资金使用效率的原则，公司适当调整了投资节奏。“集成电路用8英寸硅片扩产项目”分两个阶段执行，目前第一阶段5万片/月的产能已经建设完毕，公司8英寸硅片产能已达到18万片/月，且保持了较高的产能利用率；同时，第二阶段建设已经启动。“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响，开工较预期延迟。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情

况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“集成电路用8英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”达到预定可使用状态的日期均调整至2025年12月。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、投资总额或建设规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、本次延期募投项目的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司对募投项目“集成电路用8英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）项目必要性分析

随着物联网、人工智能、汽车电子和区块链等新兴技术的快速发展及移动终端的普及，半导体硅材料的应用呈多元化趋势。公司的集成电路用8英寸硅片及集成电路刻蚀设备用硅材料等产品在下游客户应用得到快速发展，获得了大量高品质客户的认可。为适应市场需求，公司积极推进并实现半导体硅材料的国产化，故急需增加生产线，实现增量扩产，公司募投项目已布局此细分领域，亟待抢占市场份额。公司通过扩大生产规模，增加原材料需求量，提升面对上游供应商的议价能力，从而有效降低材料成本，拉升公司整体毛利率水平，提升公司盈利能力，满足其对利润增长的需求。

（二）项目可行性分析

本项目符合《国家集成电路产业发展推进纲要》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等国家相关政策的规定。公司扎实稳健的技术积累为项目建设提供了坚实的保障，同时也培养造就了一批科技创新及经营管理人才，现有管理团队均拥有多年行业从业经验。优质、稳定的下游合作商为产能消化提供助力，积极推动企业扩大生产规模、提高产能、产能消化等进程。

（三）募集资金投资项目论证结论

公司认为募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。

五、公司履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“集成电路用8英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等。保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐人同意公司本次募投项目延期事项。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年4月26日